

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2023-096

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司 MEMS 微振镜通过验证并启动试产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 8 月 9 日，因北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（简称“赛莱克斯北京”或“北京 FAB3”）代工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）微振镜通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS 微振镜 8 英寸晶圆的小批量试生产。

MEMS 微振镜（也称“微镜”、“扫描镜”）是指采用光学 MEMS 技术制造的，把微光反射镜与 MEMS 驱动器和传感器集成在一起的光学 MEMS 器件。近年来，随着智能化、电动化、网联化的加速发展，汽车传感器市场持续扩大，基于半导体制造工艺生产的先进传感器正在扩大应用。MEMS 微振镜是激光光束操纵的核心元器件，通过半导体制造工艺进行集成化生产，能够实现激光雷达、激光显示的小型化、低成本、高精度，助力推进 MEMS 微振镜在车载和 AR/VR 等领域的应用。

近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，努力为全球通信、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务，积极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力，加速国产替代。

尽管已在多领域实现 MEMS 制造技术的积累和突破，但公司北京 FAB3 在整体上仍处于运营初期，产线的产能爬坡、良率提升是一个持续的过程，产能扩充及产量目标的实现尚需一定时间。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日